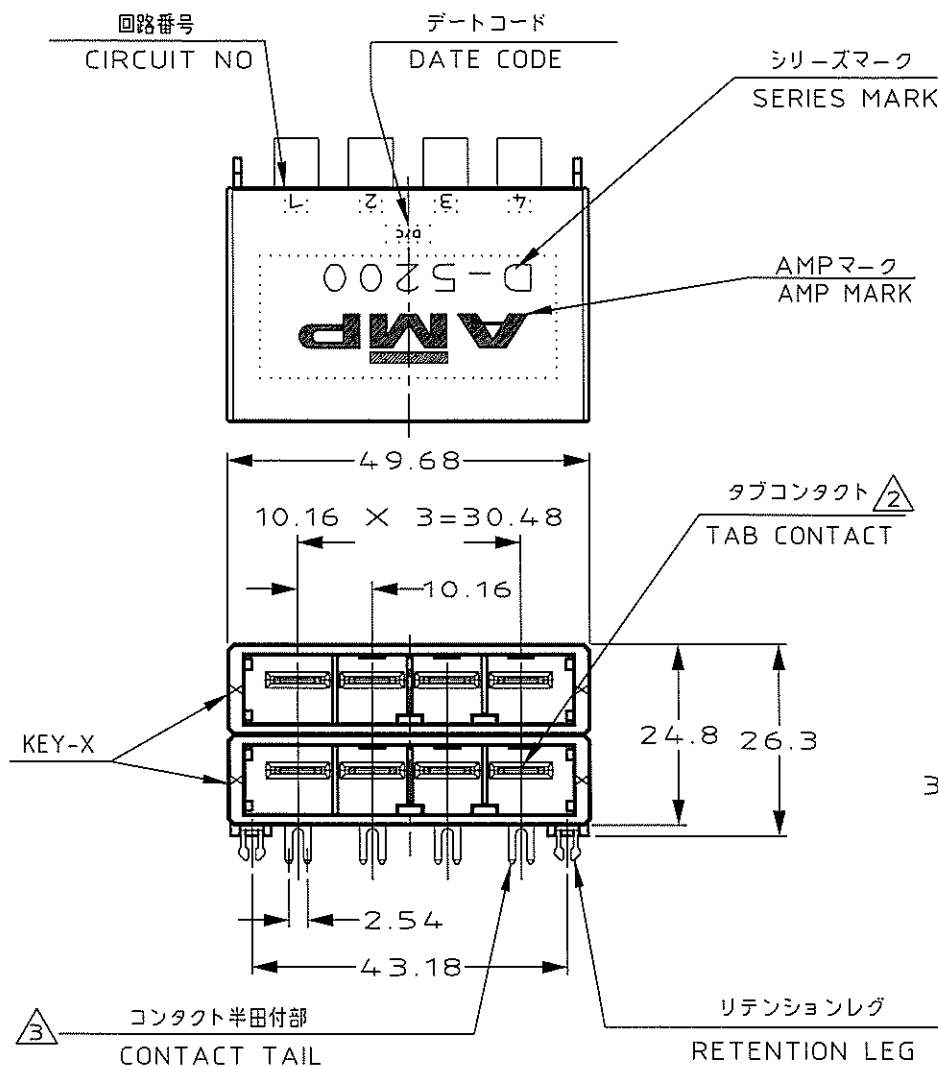


1123829-1: 本図
1123829-1:AS SHOWN



(1)
(1)
(4.55)

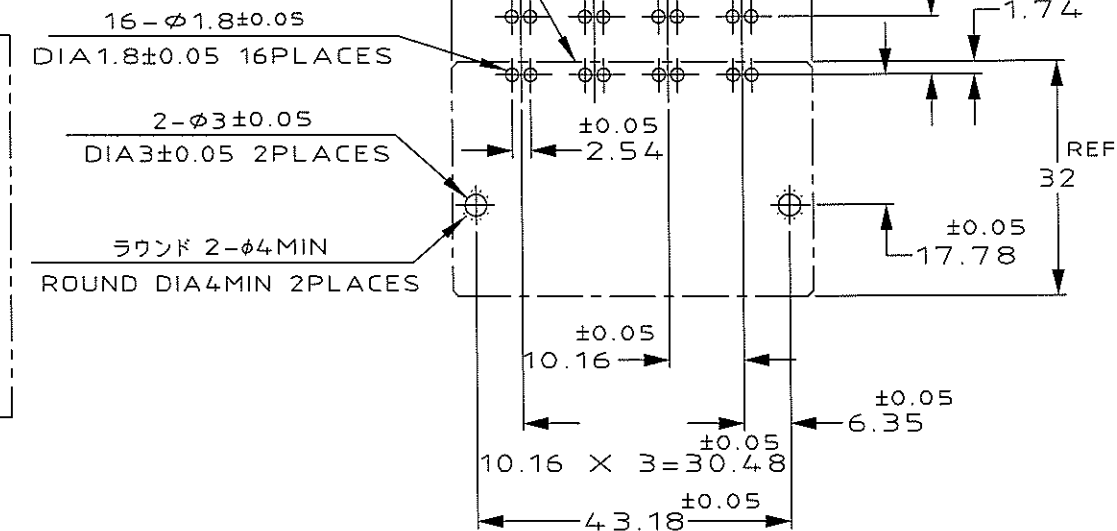
NOTES

1. MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO PLASTIC
,POLYESTER(94V-0),COLOR:BLACK
TAB CONTACT:COPPER ALLOY
RETENTION LEG:BRASS
△ FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING
△ FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED
(CONTACT TAIL) OVER NICKEL
PRODUCT SPEC. 108-5453

注記

1. 材料:ハウジング:ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂(94V-0),色:黒
タブコンタクト:銅合金
リテンションレグ:黄銅
△ めっき:コンタクト:全面Ni下地
接触部:0.38μm MIN金めっき
△ めっき:リテンションレグとコンタクト半田付部
:ニッケル下地の上にスズめっき

コネクタ外形
OUTLINE OF HEADER HOUSING



推奨基板取付け穴寸法
PC 基板厚:1.6~2.4±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMENDED PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS:1.6~2.4±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

						Copyright © 1998 AMP(Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		tyco Electronics		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
D1	REVISED (IECR-06-012820)	TS	DM	29/44Y Db							
D	REVISED (FJ00-0039-03)	TS	SM	6/2 03	WIRE RANGE	INSULATION DIA	NAME (8極 2列 水平タイプ ヘッダー アッシー)				
C	REVISED (FJ00-1758-98)	MH	NM	9/14 98	mm?(AWG -)	- mmφ	8 POS DOUBLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y «DYNAMIC D-5200»				
B	REVISED (FJ00-1390-98)	MH	NM	8/5 98	MATERIAL SEE NOTE 注記参照	FINISH SEE NOTE 注記参照	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		SIZE	LOC	NUMBER
A	REVISED (FJ00-1336-98)	MH	NM	7/13 98			10RF : ±0.3 10RA 30RF : ±0.35 30RA 100RF : ±0.4 A 真 : ±3°		A3	J	C-1123829
O	RELEASED (FJ00-0668-98)	MH	NM	6/15 98	DR. 15JUN'98 M.HIGO	DE. 15JUN'98 M.HIGO			SCALE	REV.	SHEET
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE	CHK. 15JUN'98 N.MATSUBARA	APP. 15JUN'98 I.HASEGAWA			1-1	D1	1 OF 1